

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于签署 6 英寸碳化硅晶圆项目进园框架合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的合作框架合同属于合同双方达成的合作意向和合作框架，具体合作情况视项目实际推进情况而定，后续公司将根据项目推进及实施情况，按照有关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

2、本次签署的合作框架合同涉及 6 英寸碳化硅晶圆项目，项目建设需通过政府有关主管部门窗口指导，最终是否达成合作及后续进展尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本合作框架合同预计对公司 2023 年度经营业绩不会构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响视双方具体合作的推进和实施情况而定。

4、截至本公告披露日，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

一、合同签署概况

因扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）战略发展需要，公司于 2023 年 4 月 18 日与扬州市邗江区人民政府（以下简称“甲方”）签署了《6 英寸碳化硅晶圆项目进园框架合同》，公司拟在甲方辖区投资新建 6 英寸碳化硅晶圆生产线项目，总投资约 10 亿元。

本合同为合作框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将依据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，根据相关事项的进展情况，履行相应的决策程序及信息披露义务。

二、合同对方的基本情况

1、单位名称：扬州市邗江区人民政府

2、单位性质：地方政府机构

3、地址：江苏省扬州市邗江区邗江中路 338 号

4、关联关系说明：公司与扬州市邗江区人民政府不存在关联关系。

5、最近三年公司未与合同对方发生类似交易。合同对方为地方政府机构，信用状况良好，具备充分履约能力。

三、合同的主要内容

1、项目内容

(1) 乙方拟在甲方辖区投资新建 6 英寸碳化硅晶圆生产线项目，项目总投资约 10 亿元，分两期实施建设，项目全部建成投产后，形成碳化硅 6 英寸晶圆产能 5000 片/月。

(2) 由乙方在甲方辖区内注册项目公司，项目公司负责项目开发、建设和运营，项目公司总投资、经营范围等按双方约定进行。

2、项目场所

项目位于扬州市邗江区汽车产业园新甘泉东路 56 号。项目新建厂房 27,000 平方米，其中高洁净车间（光刻区十级、操作区百级）的净化装修预计在 4,500 平方米。

3、支持政策

甲方根据扬州市和邗江区的产业政策在设备、厂房、税收、人才等方面给予乙方及项目公司优惠政策。

4、双方权利义务

(1) 甲方承诺给予乙方及其项目公司项目注册和相关办理等“一条龙”服务。

(2) 甲方积极帮助乙方及项目公司向上申报国家高新技术企业、省级以上研发机构或名牌产品以及科技攻关、人才引进、成果转化、产学研合作等项目资金支持。

(3) 甲方积极配合乙方开展项目窗口指导，并协调省市相关部门积极推进该项工作。

(4) 乙方及项目公司在本合同约定的土地使用年限内应合法经营，属地按章纳税，生产的产品应符合相关国家要求，废水、废汽、废渣排放应达到国家规定标准。

(5) 乙方及项目公司在项目建设完成后，未经甲方允许，不得将所建厂房出租或分割出租给第三方使用。

(6) 项目规划验收后，乙方及项目公司未经甲方批准不得私自搭建构筑物或者任何建筑物，如有违反，甲方可以委托第三方无条件拆除，且由此产生的所有费用由乙方承担。

(7) 乙方及项目公司不得擅自改变主营业务，若投产后因市场变化等原因无法继续经营需改变主营业务，乙方及项目公司需及时向甲方申请，在征得甲方同意后，由甲乙双方变更或重新签订项目投资合同。

5、其他

本合同所涉及项目尚需获得政府有关主管部门窗口指导并办理项目立项、项目备案、环评审批等前置审批程序，若因相关政策等实施条件因素发生变化导致该项目终止，则本合同自项目终止之日起自动失效。

四、合同对上市公司的影响

作为第三代半导体材料的核心，碳化硅与传统的硅半导体相比，具有宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等突出优点，可以在更高温度、更高电压、更高频率和更高辐射环境下工作，并具有更高的耐用性和可靠性，在汽车、工业、IT 及消费电子等多个领域的应用中有替代硅基器件的潜力，未来前景广阔。近年来，在全球“碳达峰、碳中和”的大背景下，新能源汽车、光伏等市场景气度高企，对碳化硅产品的市场需求日益强烈，驱动碳化硅器件加速导入和发展，进一步打开了碳化硅的市场空间。

公司较早地布局了第三代半导体产业，已涉足碳化硅产品研发设计多年，形成了多项专利等知识产权，已成功开发并向市场推出 SiC 模块及 650V SiC SBD、1200V 系列 SiC SBD 全系列产品，SiC Mosfet 已取得关键性进展，后续拟进一步布局 6-8 英寸碳化硅芯片生产线建设。若本次合作框架合同能实施落地，有利于充分发挥公司的技术研发、运营管理及客户资源等核心优势，及扬州产业政策、区位条件等优势，帮助公司抓住碳化硅市场发展的良好机遇，加速提升公司

碳化硅产品的技术水平和实现产品升级,有助于将公司打造成为碳化硅领域具有行业影响力的上市公司,推动公司积极转型升级向高端制造业迈进,为功率器件国产化贡献力量。

本框架合同签署预计对公司 2023 年度经营业绩不会构成重大影响,对公司未来年度经营业绩的影响视双方具体合作的推进和实施情况而定。

五、风险提示

1、本次签署的合作框架合同属于合同双方达成的合作意向和合作框架,具体合作情况视项目实际推进情况而定,后续公司将根据项目推进及实施情况,按照有关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

2、本次签署的合作框架合同涉及 6 英寸碳化硅晶圆项目,项目建设需通过政府有关主管部门窗口指导,最终是否达成合作及后续进展尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1、截至本公告披露日,公司最近三年披露的公司所签署的合作框架协议的进展情况如下:

序号	协议名称	协议对手方	披露日期	进展情况
1	《战略合作协议》	中芯集成电路制造(绍兴)有限公司	2020年2月18日	正常履行中

2、合同签订前三个月内上市公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动情况

(1) 2023 年 4 月 12 日,公司控股股东江苏扬杰投资有限公司参与转融通出借公司股份 5,127,600 股,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于控股股东转融通证券出借计划实施完毕的公告》(公告编号:2023-022)。

(2) 2023 年 4 月 17 日和 4 月 18 日,江苏扬杰投资有限公司参与转融通出借的部分股份 548,900 股归还。

3、未来三个月内上市公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持的计划

未来三个月内,公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高不存在所持限售

股份即将解除限售的情况，目前暂无股份减持计划。

七、备查文件

扬州扬杰电子科技股份有限公司与扬州市邗江区人民政府签署的《6英寸碳化硅晶圆项目进园框架合同》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日